

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2025-013

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	BLACKROCK; J. P. MORGAN; ARTISAN PARTNERS; CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEME; E FUND MANAGEMENT CO., LTD.; FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH; FRANKLIN TEMPLETON; FULLERTON FUND MANAGEMENT; GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT; GIC PRIVATE LIMITED; JENNISON ASSET MGT; PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED; SANDS CAPITAL MANAGEMENT LLC; UG INVESTMENT ADVISERS LTD; TRANSLATOR。
时间	2025 年 5 月 19 日 14: 00
地点	现场交流
上市公司参加人员姓名	董事长：郑荏 董事会秘书：龚小刚
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司的汽车安全气囊芯片业务最新进展如何，有什么竞争力？ 答：目前，在汽车安全气囊芯片领域，公司已经开发推出了安全气囊主控芯片、安全气囊点火驱动芯片、加速度计智能传感芯片，形成了安全气囊的 MCU+ASIC 芯片套片方案，在安全气囊芯片领域具有较强的市场竞争力，正在推进国产安全气囊产品国产化率不断提升。作为国内首颗获得 TÜV 北德 ISO 26262 ASIL-D 功能安全产品认证的安全气囊点火驱动芯片，CCL1600B 芯片已在多家整车厂实现装车应

用和批量出货，并有多家客户完成了 DV/PV 实验，配合国芯科技 MCU 芯片+加速度传感器芯片，形成了汽车安全气囊的全国产化解决方案，为国内车企供应链安全提供了强有力的支持。公司的 MCU 芯片在安全气囊控制器产品已实现稳定批量应用，在安全气囊控制器单点装车应用中超过 300 万颗，已充分证明了其卓越的安全性和可靠性。广汽集团与国芯科技联合开发的气囊点火芯片正在推进上车应用。

同时，公司与北京万得嘉瑞、浙江埃创、松原安全、安徽拙盾等积极推进安全气囊芯片的创新与应用。北京万得嘉瑞于 2024 年 12 月与国芯科技达成战略合作，积极在安全气囊控制器项目中选用国芯科技的“CCFC201XBC 系列+CCL1600B 系列”套片方案。2024 年 11 月 13 日，国芯科技与松原安全正式签署战略合作框架协议，双方携手旨在打造国内最具竞争力的气囊点火方案，提升国产汽车安全系统的性能和可靠性，松原安全积极在安全气囊控制器项目上选用国芯科技的“CCFC201XBC 系列+CCL1600B 系列”的配套方案，目前已实现批量供货。2025 年 3 月 21 日国芯科技-安徽拙盾安全气囊技术联合实验室揭牌。该实验室将促进芯片技术与安全气囊控制器技术的融合创新。

公司在安全气囊应用领域的创新与合作为中国汽车产业的供应链安全注入强劲动力。

2、公司在推进汽车电子芯片产业生态建设上做了哪些工作？

答：国芯科技建有江苏省汽车电子芯片工程研究中心，致力于建设自主可控的“芯片-软件-模组-整车应用”生态链，实现我国汽车产业的供应链安全。同时，在苏州市政府及高新区的支持下，公司牵头联合东南大学集成电路学院、清华大学苏州汽车研究院等科研院所，奇瑞、科世达、奥易克斯等整车和模组厂商，共同组建了“苏州自主可控汽车电子芯片创新联合体”，构建了覆盖“芯片设计-车规测试-整车应用”的全生态链。公司深度整合国内国际资源，建立了对标国际主流芯片厂商的软件开发体系，与多家 Tier1 厂商和核心供应商合作，形成了“芯片-系统-整车”全链条创新生态，加速汽车核

	心部件国产化进程。 近日，国芯科技和知行汽车科技（苏州）股份有限公司、润芯微科技（江苏）有限公司、昆山沪光汽车电器股份有限公司、苏州孔辉汽车科技有限公司、苏州环球科技股份有限公司等 7 家单位联合发起设立苏州市汽车电子及零部件产业商会，苏州市汽车电子及零部件产业商会现有会员单位 107 家，作为苏州市汽车电子及零部件产业商会发起单位和常务副会长单位，国芯科技积极通过深入的技术研讨和业务洽谈，促进企业间的优势互补与资源共享，强化产业链协同创新，携手应对行业发展机遇与挑战，共同推动汽车电子产业的高质量发展。 3、贵公司在推进 RISC-V 产业化应用上开展了哪些工作，产业化进展情况怎么样？ 答：早在 2017 年，公司便开始从事基于 RISC-V 架构的研发和产业化应用，基于开源 RISC-V 架构开发自主 C*Core CPU，并将其视为实现公司技术突破与拓展产业应用的重要契机之一，公司已在 RISC-V 架构研发和产业化应用上取得重要进展，已成功开发系列化的 RISC-V 架构 CPU IP 内核，特别是公司成功推出了自主设计的 CRV7 多核处理器，CRV7 对标国外的 Cortex-A55，其性能超越 A55，具备高性能、低功耗、高安全性等特点，工作频率最高可达 1.5GHz，能够为各类复杂应用提供强大的计算能力支持。 立足信创和信息安全市场优势，国芯科技积极发展高性能 RISC-V 云安全芯片和低功耗 RISC-V 端安全芯片产品。2025 年 4 月已经推出超高性能 RISC-V 云安全芯片 CCP917 新产品，SM2 签名效率达到 100 万次/s，对称算法性能达到 80Gbps，达到行业先进水平，为云安全应用场景下的数据处理提供高带宽、低延迟、快响应支撑，可以广泛应用于服务器、数据中心等各个领域。公司基于 RISC-V 的端安全芯片 CCM3310S-L 和 CCM3310S-LP 已实现规模化的销售应用。 在汽车电子领域，公司已启动首颗基于 RSIC-V 架构的高性能车规 MCU 芯片 CCFC3009PT 的设计开发，有望实现对目前在智能座舱和
--	---

	自动驾驶领域大量应用的英飞凌 TC397 和瑞萨 U2A16 芯片的国产化替代。 在 AI MCU 芯片领域，公司基于 RISC-V CPU 架构已推出两款 AI MCU 芯片 CCR4001S 与 CCR7002，正在智能家居、工业自动化等领域推广应用，部分应用场景陆续实现小批量应用和出货。目前已经实现量产的方案包括商用空调和婴儿看护等；正在研发的产品和方案：拉弧检测、电力检测、安防、老人看护、电机控制、配电柜温度监控、家用空调的舒适度方案、汽车空调舒适度方案和智能微波炉等。 2025 年 5 月 10 日，苏州成立了 RISC-V 开源芯片产业创新中心，国芯科技作为主要运营单位将联合 RISC-V 产业链上下游企业和单位共建 RISC-V 开源芯片产业创新中心，加快打造产业协同生态。下一步，国芯科技将认真推进各项建设任务，联合高校、科研院所、产业链上下游企业，定期组织开展技术研讨、联合攻关、场景应用、生态建设等各类活动，不断集聚国内外 RISC-V 创新资源，全力推进 RISC-V 芯片技术和产品国产化应用。 说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告、临时报告及公司在上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 5 月